

证券代码：603920

证券简称：世运电路

广东世运电路科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 与人数	东方阿尔法基金、红土创新基金、瑞银资管、华润元大基金、金信基金、西部利得基金、平安基金、创金合信基金、民生基金、诺安基金、永赢基金、融通基金、银华基金、国寿养老、万联证券、浙商证券、天风证券、东北证券、万联证券、国联民生证券、财通证券、华福证券、中泰证券、长江证券、德毅资产、深圳前海联合利业资产、深圳前海联合利业资产、基石资本、深圳前海行健资本、深圳市榕树投资、广东恒昇基金、新世界金控、广州工控、重庆诺鼎资产、华强集团、武汉美阳投资管理、古曲基金、广州泽恩投资、浙江君弘资产、上海瞻程投资、慕思股份、华富基金、金元证券、杭州国睿投资、深圳市榕树投资、深圳市长青藤资产等 46 家机构。
时间	2026 年 6 月 3 日 15:00—17:30
地点	公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待 人员姓名	董事、总经理：余英杰先生 董事、副总经理：王鹏先生 董事会秘书：尹嘉亮先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	主要内容整理： 公司管理层向来访者介绍了公司基本情况，包括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容，并与来访人员进行互动交流，主要内容如下： Q1. 为什么 PCB 行业会出现芯片内嵌式 PCB 封装技术？ 芯片内嵌式 PCB 封装技术不是突然出现的新概念，而是功率半导体、PCB 高密度互连、汽车电子高可靠性和系统级封装共同演进的结果。传统 PCB 主要承担线路连接和机械承载功能，芯片先由封装厂完成封装，再焊接到 PCB 上。

新能源汽车、AI 服务器、储能和机器人等应用快速发展后，系统功率更高、开关频率更高、空间更紧凑，传统“封装后上板”的模式开始暴露瓶颈：互连路径长、寄生电感高、散热路径复杂、体积重量受限，且键合线和多级焊点在热循环、振动和功率循环中容易成为失效点。特别是在 800V 以上高压架构下，上述性能瓶颈尤为显著。

行业演进路径可以概括为三步：先是 HDI、激光微孔、多次压合和精细线路等高密度互连技术成熟；随后是埋阻、埋容、埋铜等嵌入式元器件技术发展；最后升级至埋有源芯片，尤其是将功率芯片直接埋入 PCB 内部。

因此，埋芯技术本质上是 PCB 制造与半导体封装的融合。它不是简单把芯片藏进 PCB，而是把原来分散在封装、功率模块、连接器、驱动板和散热结构中的部分功能，重新集成到 PCB 体系内。

Q2. 世运电路的技术来源是什么？公司为什么具备从事内嵌式 PCB 业务的基础？

世运电路的技术一方面来自行业从“连接板”向“芯片互连与系统封装载体”升级的趋势，另一方面来自公司在汽车电子和高端 PCB 领域的长期积累。公司不是从零跨界做半导体封装，而是在原有 PCB 制造能力上向芯片互连、高功率模块和系统级集成的延伸。

公司的底层能力来自长期服务汽车电子、工业控制、AI 服务器、通信设备和消费电子客户形成的高可靠制造经验。高多层板、HDI、金属基板、软硬结合板和车规 PCB 能力，是埋芯技术的工艺基础。

更直接的研发载体，是公司于 2022 年获批成立的“新一代电动汽车高端芯片互连载体创新平台”。公司依托该平台发展芯片内嵌式 PCB 封装技术，通过嵌埋工艺将功率芯片直接嵌入 PCB 板内，实现器件与 PCB 一体化，优化信号传输、功率传输和散热路径。

这条路线可以概括为：以汽车电子高可靠 PCB 为基础，以新能源汽车和 AI 高功率应用需求为牵引，以高端芯片互连载体创新平台为研发载体，最终形成芯片内嵌式 PCB 封装技术。

Q3. 内嵌式 PCB 较传统 PCB 产品有什么核心优势？

相较传统 PCB 和传统功率模块，内嵌式 PCB 封装技术的优势集中在电气性能、散热性能、结构集成、可靠性和系统价值五个方面。

电气性能方面，传统方案的键合线和长路径连接会带来寄生电感、电压过冲和开关损耗。埋芯方案通过消除或减少键合线，采用超短连接路径，降低寄生参数，有助于降低开关损耗和电压过冲。

散热性能方面，传统方案的热量需要经过芯片、焊料、基板和散热底板等多层路径。埋芯方案可以围绕芯片直接设计导热路径，缩短热传导链条，改善高功率运行下的热稳定性。

结构集成方面，传统方案需要封装器件、连接端子、驱动板和散热结构堆叠，占用空间较大。埋芯方案把部分封装、互连和散热功能集成到 PCB 内部，有利于提升功率密度，减少封装体占用空间。

可靠性方面，键合线和多级焊点是热循环和机械应力下的潜在失效点。埋芯方案可以减少键合线失效风险，提升芯片互连的可靠性。

系统价值方面，客户不只看单片 PCB 成本，更看重系统效率、体积、散热、可靠性和总成本。埋芯技术通过一体化结构降低系统复杂度，价值量高于普通 PCB。

Q4. 内嵌技术主要应用在哪些场景？市场空间怎么看？

内嵌技术的空间不能只按单一 PCB 品类理解，而要看高压化、高功率化、高频化、小型化趋势下，传统功率模块和传统 PCB 方案能否继续满足系统需求。

新能源汽车动力领域是最直接的应用。800V 高压平台、SiC 功率器件、主驱逆变器和车载电源对效率、散热和可靠性的要求提高，公司围绕主驱逆变器、车载电源、DC/DC 和电控系统等高功率密度模块切入。

AI 数据中心和服务器电源是高弹性方向。AI 算力提升带来机柜功率上行，供电系统需要更小的体积和更高的效率及可靠性，公司可切入高压直流供电、服务器电源、SST 固态变压器和板级垂直供电等方向。

储能与光伏逆变强调长期高功率运行。储能 PCS 和逆变器对开关损耗、热管理、寿命和安全性要求高，公司可面向储能 PCS、光伏逆变器、高压电

源模块提供配套产品。

机器人、低空飞行器和小型化消费电子是后续拓展方向。机器人需要更小体积和更高响应速度，可用于关节驱动、电源管理、运动控制和伺服模组；低空飞行器强调轻量化和高可靠性，可用于飞控、电源管理和驱动控制；AI 智能眼镜、TWS、折叠屏等则更看重空间、厚度、散热和集成度。

中长期看，空间来自两部分：一是新能源汽车、AI 数据中心、储能、机器人等下游行业的增长；二是 PCB 从传统制造环节向半导体封装互连环节延伸后，单产品价值量和客户黏性的提升。

Q5. 目前公司内嵌工艺中试进展如何？

结合此前已经公开披露的信息，公司芯片内嵌式 PCB 产品已通过一系列静态、动态测试，达成性能设计和信赖性要求，并陆续获得终端主机厂客户项目定点。

产能方面，公司拟投资约 15 亿元建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目，建设地点位于鹤山市共和镇铁岗工业区，主要产品包括芯片内嵌式 PCB 产品和高阶 HDI 电路板产品，该项目目前处于主体工程建设阶段。

公司已在现有厂区建成内嵌式 PCB 中试线，以满足客户小批量需求，并持续验证产品可靠性。

Q6. 如何考量内嵌式产品的成本与价值？

内嵌式产品不能简单按照传统 PCB 的平方米单价理解。传统 PCB 主要赚制造加工价值，而内嵌式 PCB 把部分封装、互连、散热和系统集成功能集成进 PCB 内部，产品价值量和客户价值都发生了变化。

客户关注的不仅是单片 PCB 成本，而是系统总成本、体积、效率、散热、可靠性和良率。如果内嵌式方案能够减少封装体占用空间、缩短互连路径、降低系统损耗、提高可靠性，并减少下游装配复杂度，即使单件价格高于传统 PCB，也能在系统层面更具性价比。

Q7. 海外头部企业的人形机器人即将量产，公司配套 PCB 产品已完成三代迭代，目前机器人业务最新定点份额是多少？量产后，预计可为公司带来多少营收增量？

公司自 2020 年起便配合客户开展该业务 PCB 产品的研发与生产工作，依托深耕新能源汽车电路板积淀的技术经验，加上该业务核心模块与车载 FSD 系统设计高度同源，现已构建起定制化设计、快速打样、性能优化的全流程技术体系，累计完成 3 代产品迭代升级，在信号传输、抗干扰性能上形成技术壁垒。目前公司产品可满足该业务中央控制、视觉感知、关节驱动等核心系统电路的需求，公司现有产线已完成对应的技术与产能储备，未来将积极把握后续量产带来的发展机遇。

Q8. 公司 AI 相关业务进展如何？

2025 年公司 AI 相关业务，主要通过 OEM 模式为英伟达、AMD、Google 供应相关产品，核心包括为安费诺提供配套连接器件，相关业务推进顺利，对公司产品结构优化及毛利率提升有明显贡献，目前公司正在积极导入其核心算力产品。同时，公司正在积极推进与数据中心能源供应相关的内嵌式产品方案落地，预计 2026 年 AI 业务将维持增长态势。泰国工厂、鹤山二期的高端产能可全面匹配 AI 高端产品的需求，支撑业务实现更快增长。

Q9. 当前 PCB 上游 CCL、玻纤布、铜箔持续涨价，请问公司现阶段产品顺价落地的实际进度如何？本轮成本上涨已完成多少比例的价格传导？

原材料涨价在 2025 年四季度已逐步与下游客户商议提价事宜，并得到客户普遍支持。但由于业务周期较长，加上原材料价格持续上升，利润修复体现相对滞后。为了应对成本上升，公司新料号在定价时已充分考虑原材料涨价与供需结构，海外客户重视保供，接受度较高。公司将适度加大原材料策略备库、优化库存管理，同时持续优化产品结构，提升高阶 HDI、嵌入式 PCB 等高附加值产品占比，多举措并行对冲成本上涨的压力，驱动公司整体盈利能力的稳步修复。

Q10. 公司如何展望 2026 年下半年整体经营走势？全年整体营收、毛利、利润率的修复节奏具体如何？公司整体盈利能力是否迎来系统性抬升？

面对当前市场环境，公司始终坚持稳健经营与长期发展并重，多措并举夯实核心竞争力、释放长期增长潜力。首先，公司将加快全球化高端产

	<p>能释放，全力推进泰国基地达产爬坡、鹤山五厂高端产能落地，完善海内外双基地布局，全面提升交付能力与供应链抗风险能力；其次，持续深化高端化转型，大力优化产品结构，积极提升高阶 HDI、高多层板等高附加值产品占比，以技术升级与产品溢价平滑成本波动；三是加速前沿技术产业化，推进芯创智载内嵌式 PCB 项目规模化落地。随着新产能的释放、良率提升和产品结构优化，公司盈利能力有望得到稳步提升与修复。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件（如有）</p>	<p>无</p>